

KYOCERA KE-1150

Epoxy; Epoxide

KYOCERA Chemical Corporation

Описание материалов:

Special Epoxy Molding Compounds Optimizing Warpage and Applicable to Fine Pitch Wire for BGA Package
Strong Points

Less Warpage in All Types of Area Array Packages due to High Tg Characteristic.

Applicable to Fine Pitch Wire Bonding with Good Wire Sweep Performance.

Achieve High Yield after Molding due to Excellent Moldability that allows its application to MAP.

Application

Standard P-BGA, HS-BGA and LGA Package.

Multi Chip Module (Stacked or Side by Side Layout)

IC Card, Memory Card etc.

Low Alpha Ray Type: KE-2150

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая плавность	
Используется	Электрическое/электронное применение	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	2.00	g/cm ³
Spiral Flow	190	cm
Вязкость раствора	5000	mPa·s
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Флекторный модуль	18000	MPa
Flexural Strength	150	MPa
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	185	°C
CLTE-Поток		
-- 1	1.0E-5	cm/cm/°C
-- 2	4.5E-5	cm/cm/°C
NOTE		
1.	Alpha 1	
2.	Alpha 2	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

